



Grâce à son **système en ligne totalement automatisé**, la **gamme CX** représente la solution de refusion phase vapeur pour la production de grandes séries (**temps de cycle <20s par PCB***). Son **mode Soft Vapor Control** breveté, son **mode piloté**, son système de gestion d'énergie, ses 2 stations de chargement / déchargement des PCB indépendantes situés en zone froide, une refusion **exempte d'oxygène** et **sans apport d'azote**, l'absence totale de surchauffe des assemblages et ses 3 chambres séparées assurent une **flexibilité de process**, une **reproductibilité des profils**, et une **qualité de brasage maximales** tout en réduisant significativement son coût de fonctionnement comparativement aux moyens conventionnels de refusion (**consommation électrique: 3.2 kW/h seulement, et très faibles coûts de maintenance**).

* selon taille du produit et temps de cycle

Généralités

- 2 stations de chargement / déchargement des PCBs indépendantes
- 3 chambres process avec sas de séparation d'atmosphère
- Possibilité de braser en mode batch et en ligne de manière simultanée
- Logiciel de profilage intégré sans data logger externe
- Sauvegarde des données de production
- Large gamme de profils de brasage pré-enregistrés
- Système de gestion d'énergie incluant un mode veille pour consommation réduite
- Programmation simple et conviviale des paramètres process grâce à un écran tactile couleur
- Système transport sans maintenance (**breveté**)
- Niveau de fluide contrôlé + filtrage automatique
- Hublot sur chambre de process

Spécificités

- IPS, Système Intelligent de Profilage, pour :
 - Mode SVTC (Soft Vapor Temperature Control) pour le contrôle du gradient de température tout au long du profil
 - Mode piloté, paramétrage et profilage en une seule étape
- Les profils de T° peuvent être visualisés, enregistrés et reproduits indépendamment des contraintes extérieures (ex. conditions de chargement)
- Profilage de température en temps réel intégré
- Système transport sans maintenance (**breveté**)

| Données techniques | CX600 | CX800 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Longueur (hors tout) | 5950 mm (incluant le panier de chargement) | |
| Largeur | 1980 mm | 2390 mm |
| Hauteur | 1500 mm | 1500 mm |
| Poids | 1980 kg | 2090 kg |
| Hauteur chargement / déchargement | 870 - 950 mm (variable) | |
| Taille Max. de cartes (mode manuel ou Batch) | 680 x 646 x 65 mm | 680 x 826 x 65 mm |
| Taille max. de cartes (mode en ligne) | 680 x 305 x 45 mm | 680 x 510 x 45 mm |
| Capacité fluide caloporteur | 40 kg | 45 kg |
| Raccordement eau | 1/2" / 2,5-5 bar / 3l/min | |
| Puissance maximum de chauffe | 6,4 kW | 10,4 kW |
| Puissance consommée | 3,2 kW | 5,3 kW |
| Alimentation électrique | 400/230 VAC, 50/60 Hz, 3 phases, Neutre et Terre, 6,8 kW | |
| Fusible principal | 20A, Typ "gL" ou "C" | 32A, Typ "gL" ou "C" |

- Sous réserve de modifications techniques

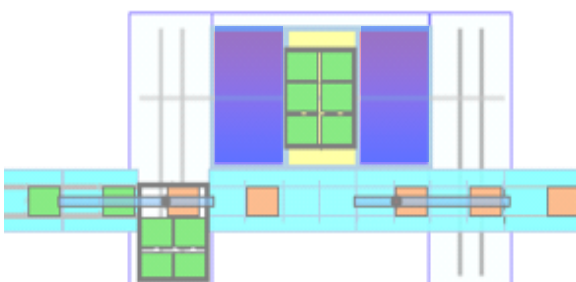
Caractéristiques techniques

- Chargement / déchargement automatique des paniers
- 2 paniers composés de 4 lignes de chargement avec rail central anti-flexion
- Ajustement automatique des rails supports de charge
- Interface SMEMA
- Mode Syncro pour process reproductible
- Voies de mesure de T° intégrées
- Système de contrôle de chauffe
- Chambre de refroidissement intégrée
- Système de récupération de fluide
- Indicateur lumineux d'état de production
- Fonctionnement du PC intégré avec écran TFT

Options

- Interface Siemens
- Module de refroidissement
- Panier pour chargement manuel (batch)
- 2 voies supplémentaires de mesure de température thermocouple (NiCrNi)
- Logiciel VP de mesure de T° (système PTP)
- Panier 4 lignes avec rail central
- Onduleur (UPS)
- Transformateur pour 480V ou 208V Triphasé

Schéma de principe de fonctionnement (gamme CX vue de dessus)



Réalisation de profils thermiques:

Mode SVP (Soft Vapor Phase mode) **Breveté**

Schéma de principe de fonctionnement

Les différentes positions dans la vapeur du mode SVP permettent d'obtenir le profil optimal souhaité (parfaite maîtrise et changement instantané de la pente thermique jusqu'au pic de refusion).

